

USB3.0A R1V 3.0N2 TY BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



산업용 사용을 위한 신뢰할 수 있는 데이터 인터페이스인 USB 장점이 많기 때문에 USB 잭은 전기 산업에서 항상 가장 많이 사용됩니다.

USB-A, -B, -C 및 -Micro 부품의 광범위한 포트폴리오는 최대 10 Gbit/s의 속도로 미래형 장치 디자인을 가능하게 합니다. 당사의 USB PCB 잭은 빠르고 쉬운 데이터 전송을 위해 견고한 표준 USB 2.0, 3.0 및 3.1을 지원합니다.

개별 커넥터는 높은 내구성에 대한 요구 사항을 충족하며 안정적인 연결을 제공합니다.

- 최대 10.000 플러그 주기
- THT, THR 또는 SMD 솔더링 프로세스
- 180° (수직/직립) 또는 90° (수평/평면) 디자인 유형으로 이용 가능
- 트레이(TY) 또는 테이프 온 릴(RL)에 담아 포장
- 내부식성 향상을 위한 강화 골드 레이어
- 빠른 데이터 전송을 위한 10 Gbit/s의 데이터 속도를 지원하는 USB 3.1 잭
- 대칭적인 디자인으로 오류 없이 꽂을 수 있는 USB-C 잭
- 강력한 Plug & Play 작동 - 시스템을 종료하거나 다시 시작하지 않고 연결 및 분리

일반 주문 데이터

버전	OMNIMATE 데이터 - USB 잭, PCB 플러그인 커넥터, USB 3.0, 타입 A, 5 Gbps, THT/THR 용접 결선, 180°, 플러그 주기: ≥ 1500, 극 수: 8, LCP, 금 도금 니켈, 트레이 (수작업 조립)
주문 번호	1549730000
유형	USB3.0A R1V 3.0N2 TY BL
GTIN (EAN)	4050118356083
수량	500 items
파키징	트레이 (수작업 조립)

USB3.0A R1V 3.0N2 TY BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com
기술 데이터**승인**

RoHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	7.1 mm	깊이 (인치)	0.2795 inch
높이	18.9 mm	높이 (인치)	0.7441 inch
가장 낮은 버전의 높이	14.95 mm	너비	14.65 mm
폭 (인치)	0.5768 inch	순중량	0.41 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

전기 속성

절연 강도, 접점/접점	100 V AC	절연 저항	$\geq 1000 \text{ M}\Omega$
공칭 전압	30 V	정격 전류	1.5 A

시스템 사양

극 수	8	LED	아니요
슬더 핀 길이(I)	3 mm	PCB에 장착	THT/THR 용접 결선
피치(인치)(P)	0.079 "	차폐 재질	황동
차폐	Yes	측면 종단, 특성	용접 플랜지
전송 속도	5 Gbps	풀당 용접 핀 수	1
결선 유형	용접 결선	슬더 구멍 직경(D)	0.7 mm
제품군	OMNIMATE 데이터 - USB 잭	피치(mm)(P)	2.00 mm
보호 등급	IP20	플러그 주기	≥ 1500
결선	유형 A, USB 3.0	외향 엘보	180°
차폐 표면	니켈 도금	실드 탭	없음
성능 카테고리	5 Gbps	슬더링 프로세스	리플로우 슬더링, 수작업 슬더링, 웨이브 슬더링
슬더핀 크기	8각형	슬더핀 위치의 공차	$\pm 0.1 \text{ mm}$

자재 데이터

절연재	LCP	컬러 코드	파란색
컬러 차트(유사)	RAL 5012	절연재 그룹	II
CTI(Comparative Tracking Index, 비교	≥ 500	절연 저항	$\geq 1000 \text{ M}\Omega$
추적 지수)			
Moisture Level (MSL)	1	UL 94 가연성 등급	V-0
접점 기본 재질	인 청동	접점 재질	구리 합금
접점 표면	금 도금 니켈	플러그 접점의 레이어 구조	30...80 μm Ni / $\geq 30 \mu\text{m}$ Au
보관 온도, 최소	-40 °C	보관 온도, 최대	85 °C
작동 온도, 최소	-40 °C	작동 온도, 최대	85 °C

패키징

패키징	트레이 (수작업 조립)	VPE 길이	257.00 mm
VPE 폭	222.00 mm	VPE 높이	10.00 mm

USB3.0A R1V 3.0N2 TY BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**중요 참고 사항**

참고 사항

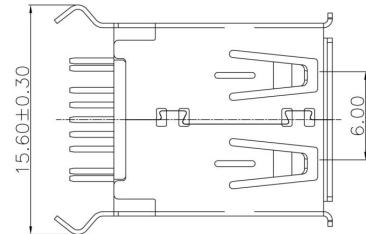
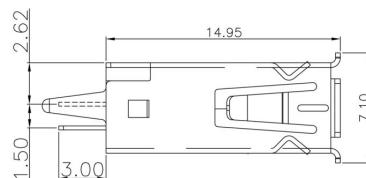
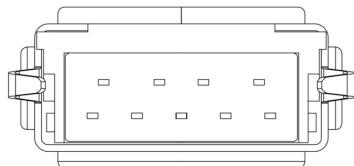
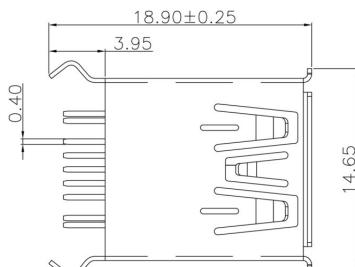
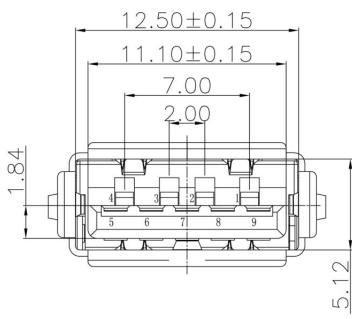
분류

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

USB3.0A R1V 3.0N2 TY BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

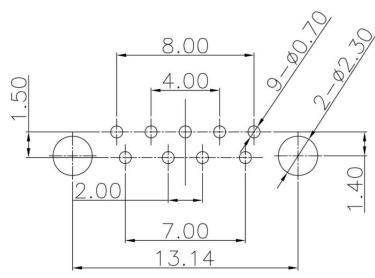
www.weidmueller.com

도면**치수 도면****치수 도면****치수 도면****치수 도면****치수 도면**

USB3.0A R1V 3.0N2 TY BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

도면**PCB 디자인**

PCB LAYOUT

범례

USB	3.0A	R	1	V	3.0	N	4	TY	BL	USB3.0A R1V 3.0N4 TY BL
										Colour / Special Option
										BL blue (plastic) BK black (plastic) WH white (plastic) SO customized product
										Packaging
										TY Tray in box (manual assembly) RL Tape on Reel (automated assembly) TU Tube
										Contact surface thickness
										4 1 = 3µ", 2 = 6µ", 3 = 15µ", 4 = 30µ", 5 = 50µ"
										N no use
										Solder Pin length
										3.2 3.2 mm 1.6 1.6 mm D SMD
										Direction
										H Horizontal (90°, side entry) U Horizontal, Upright 90° V Vertical (180°, top entry)
										Number of Ports
										1 1 Port 21; 41; ... multi ports about each other, Multilevel
										Assembly on PCB
										R Through Hole Reflow - THR Soldering process: Wave or Reflow soldering S Surface Mount Technology - SMT T Soldering process: Reflow soldering Through Hole Technology - THT Soldering process: Wave
										Type / Performance
										2.0A USB 2.0 Type A 3.0A USB 3.0 Type A